公開特許公報

① Int. Cl.²
G 11 B 5/60
G 11 B 5/10

識別記号

❸日本分類102 E 506102 E 50

庁内整理番号 7630-55 6161-55 ❸公開 昭和53年(1978)6月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

Ø磁気ヘッド

②特 願 昭51-144746

②出 願昭51(1976)12月3日

仰発 明 者 梁島忠彦

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 仍発 明 者 太田幸雄

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

の出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 森田寛

明 細 客

1. 発明の名称 一一磁気ヘッド

2. 特許請求の範囲

(1) 走行移動する磁気配像媒体記憶面に対踪されて配置されかつ磁気ヘッド・コアがもりけられるスライダを有する磁気ヘッドにおいて上配スライダの背面上に貼着された導電パターンをもつ絶録性フイルムをそなえ、該絶録性フイルムにもりけられた導電パターンに対してフェース・ダウン・ボンデイングされたICチップをもりけたことを特徴とする磁気ヘッド。

(2) 上配絶級性フィルムは上配Iピテップのパッドに対応した位置にもうけられたパッド・パターン部をそなえ、上配Iピチップの上配パッドは上配パッド・パターン部に圧着され電気的に接続されることを特徴とする特許財水の範囲オ(1) 項配数の磁気ヘッド。

(3) 上配舱兼性フィルムと上記『じサップと上

配磁気ヘッド・コアに巻回された巻線とが合成樹脂によつて固定されることを特徴とする特許請求 の範囲オ(1)項またはオ(2)項配数の磁気ヘッド。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、磁気ヘッド、特にアームの先端にも うけたスライダの背面にフイルム・キャリア方式 の導電パターンをもうけ、数パターンKICチップ をフエイス・ダウン・ポンデイングにより取付け た磁気ヘッドに関するものである。

一般に例えば磁気ディスク英優においてはを 一般に例えば数がイスクリーを を受けるない。 を受けるない。 を受けるない。 を発しているのででは、 のでは、 のでは、

生ずる異による浮上力とジンパル4の弾性による。 押圧力とのパランスを利用する空気調剤パネによ つて磁気ヘッド5は磁気ディスク1の面から値か に浮上する状態に保たれる。磁気へッド5で競取 つた情報はリード娘6を通つてアーム3に固定さ れたICチップ7の茜板7-Aにもりけられた塊 子フーBからIC回路に入力され増幅されて基板 7 一 A 上の出力線により出力装置(図示せず)に 送られる。また入力装置(図示せず)より入力線 を通って『ピチップ7の回路に入力された書込み 電流はリード酸もを通つて磁気ヘッド5に供給さ れ磁気デイスクトに配録される。ことでIUチッ ブは通常パッケー ジされて基板上に取付けられる が,回転する磁気ディスク1に当接しないように オ2図図示の如くアームるに穴る一人をもりけて **設穴3一Aに埋込まれるようにされる。このため** アームるとしてはその強度を保つために必然的に 概を広く設計することが必要になつてくる。

従来一般的には上述の如く磁気ヘッド 5 と I C チップとの間に比較的長いリード線 6 が介在する。

るととを目的とし走行移動する磁気配録媒体配像 面に対峙されて配置され、かつは気へッド・ロでは がもりけられるスライダを有する磁気の、ルーに メーンをもつお最佳フィルムをそれ、設対して、 メーンをもつお最佳フィルムをそれ、設対して、 フィルムにもりけられた。以下本発明を オイルムにもりけたことを特徴としている。以下本発明を オイのをを照しつつ説明する。

オ4回は本発明の実施例構成を示す引き、 でするでは I C チップ・1 1 は新年では I C チップ・1 1 は新年では I C チップ・1 2 は新年で I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C J A は I C

このため絞りード誰6によつてノイズが混入され。 また布藤キャパシタンスが大きく磁気ヘッドのイ ンダクタンスとで発生する共扱のため彼形面と共 振ノイズが大きくたる。したがつて,リード線6 をできるだけ低くして布藤キャパションスや共振 ノイズを減少させ,信号レベルの低い所での混入 ノイズを波らす考慮がされた。その結果上記り一 ド線の長さを短かくするために対る図に図示する 如く【じチップフを載置したパッケージ10を磁 気ヘッド5の極く近くに配置することが考慮され ている。即ち遊気ヘッドからリード・パターン9 を介してパッケージ10上のICチップ7に導び き,ワイヤ・ポンデイング8KよつてICチップ 7 に 接続 する 方式 が 考慮 される。 しか しながら 磁 気ディスク1の高速回転のために生ずる風圧によ b I C チップ 7 のワイヤ・ポンデイング部がふら つき接統点等において剝離しやすくなり,特に 100.G前後の加速度が印加されることから確固 とした接続を持続することができない。

本発明の磁気デイスク方式は上記の点を解決す

巻回されている。本発明の場合,磁気ヘッドのス ライダ15の背面上に,フィルム・キャリア方式の **導電パターンをもりけ,その上にICチップをフ** エース・ダウン・ポンデイングせしめて構成 して いる。フイルム11はパターン化したリード12 をサンドイツチ状に挟んでおり、上記リード12 はICチップ7のポンディング・パッドの寸法に 合致せしめたパターン部をもち。スライダ15の 背面上に貼着される。該パッド・パターン部は要 面に露出されており、故露出されたパッド・パタ ーン部にICチップ1のパットを一致させるより にフェースダウン形式に軟置してポンディンクナ る。紋ポンディングは熱圧着または共晶法などに よるものであり、I C チップフのパッドとフィル ムのパッド・パターン部とが安定に接続される。 そして広幅線部12-Aは例えばジンパル4の長 さにあわせて切断ざれる。またヘット参譲13の 始部と端子部12一℃とは電気的に接続される。 一般には電源線,入出力 号線を構成する広閣線 部12一人の長さは作業性を上げるためにジンパ

ム、1 2 は導電パターン、1 3 はヘッド巻線、 1 4 はヘッド・コア、1 5 はスライダをそれぞれ 扱わす。

> 特許出頭人 富士通朱式会社 代理人弁理士 森 田 寬

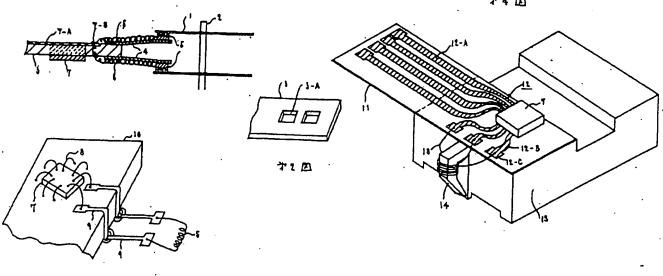
イングにより取付けるようにしたので、パッケージをもうける必要がなくなり、ポンデイングワイヤが不要となる。さらに本発明の方式を採用することにより次の附随的を大きい利点をもつるというという。 はパメーンをもつフィルムは予め多数の当 はパメーンをもつフィルムは予め多数の当 はパメーンを印刷した上でロール状に巻きこんで おくことができ、作業時に所定長さに切断してス ライダ上に貼着すればよく、磁気へッド製造工程 を自動化できることが容易となる。

4. 図面の簡単な説明

オ1回は従来の磁気デイスク装置に用いる磁気 ヘッド部分の一例,オ2回は上記オ1回回示の構 成におけるアームの構造を説明する説明図,オ3 回は本発明の前提として考慮されたICチップを ワイヤ・ポンデイングで接続する磁気ヘッドの一 例、オ4回は本発明の実施例の要部斜視図をそれ ぞれ示す。

図中、1 は磁気デイスク。3 はアーム、5 は磁気へッド、7 は I U チップ、1 1 は絶縁性フィル

Best Available Copy



Best Available Copy